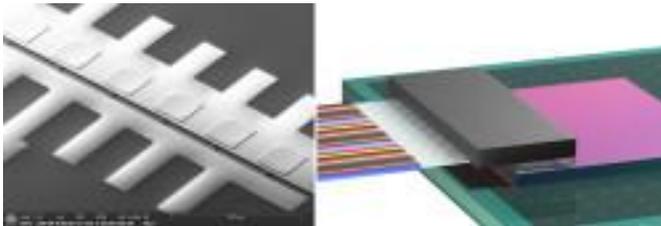


EV Group and Teramont collaborate on PIC packaging technology – March 9, 2022

EV GroupとTeramont、PICパッケージング技術で提携



March, 10, 2022, ST. FLORIAN/JERUSALEM--EV Group (EVG)とTeramontは、シリコンフォトニクス
の大きな障害、即ちファイバチップパッケージングを解決するためにウエファレベルオプティクス実装で
の提携を発表した。

EVGは、MEMS、ナノテクノロジー、半導体市場にウエファボンディングやリソグラフィ装置を供給して
いる企業、Teramontは、光ファイバとシリコンチップの接続でスケーラブルなソリューションを持つ。

協働は、EVGのナノインプリントリソグラフィ(NIL)技術、専門知見およびサービスとTeramontの
PhotonicPlug技術を利用する。

この提携で、シリコンフォトニクスチップを実装する標準CMOSウエファは、EVGのNIL技術で後加工し、
ミラーやレンズなどの光学素子をTeramont独自の「自己整合オプティクス」のために実装する。これによ
りチップや簡易接続から多数の光ファイバまで、柔軟なビーム取り出しが可能になる、また多数の光ファ
イバへの容易な接続も可能。さらに、シリコンフォトニクスウエファ製造強化のためのウエファレベル光
検査機能も可能になる。

協働は、オーストリア、St. Florian本部、EVGのNIL Photonics Competence Centerで実施されている。同セ
ンタは、NILサプライチェーンの顧客やパートナーにオープンアクセスイノベーション・インキュベータを
提供している。協働して開発サイクル、革新的なフォトニックデバイスやアプリケーションTime to Market
を短縮するためである。Teramontとの協働を通じてEVGは、プロセス開発と生産サービス、CMOSとフォ
トニクス製造の両方の専門知見を提供し、TeramontのPhotonicPlug技術の商用化を加速する。

データセンタ、通信ネットワーク、センサ、先進的AIコンピューティングにおける新興のアプリケーション
で高速データ転送の必要性が、激増している。これは次に、超広帯域パフォーマンスを可能にする、コスト
効果の優れたシリコンフォトニクスの製造を拡大するソリューション開発の重要性を駆り立てる。両社の
協働は、この問題の解決を狙っている。

TeramountのCEO、Hesham Tahaは、「EVGとの協働は、ウエファレベルオプティクスとシリコンフォトニクスウエファ製造の間のこの革新的シナジー実現で功を奏した。この機能を業界に提供することで、Teramountは、光接続のさらなる普及の主要な障害の一つを解決する。これは、高速データ転送、低消費電力を必要とする多くのアプリケーションにとって極めて重要である」とコメントしている。

「TeramountのPhotonicPlugシリコンフォトニクスパッケージング技術は、光パフォーマンスを改善する真に斬新なアプローチである。それを市場に出す手助けでパートナーになることを喜んでいる。これは、当社のNIL Photonics Competence Center で、EVGプロセスと装置ノウハウのサポートにより開発された革新的技術の最新例である。ここで、われわれは、パートナーや顧客が新しいアイデアを革新的な製品に変えることを手助けしている」とEV Group、Corporate Technology Development and IP ディレクタ、Markus Wimplingerは、コメントしている。

(詳細は、<https://www.evgroup.com>)

<http://ex-press.jp/lfwj/lfwj-news/lfwj-biz-market/46186/> <http://ex-press.jp/lfwj/lfwj-news/lfwj-biz-market/46186/>